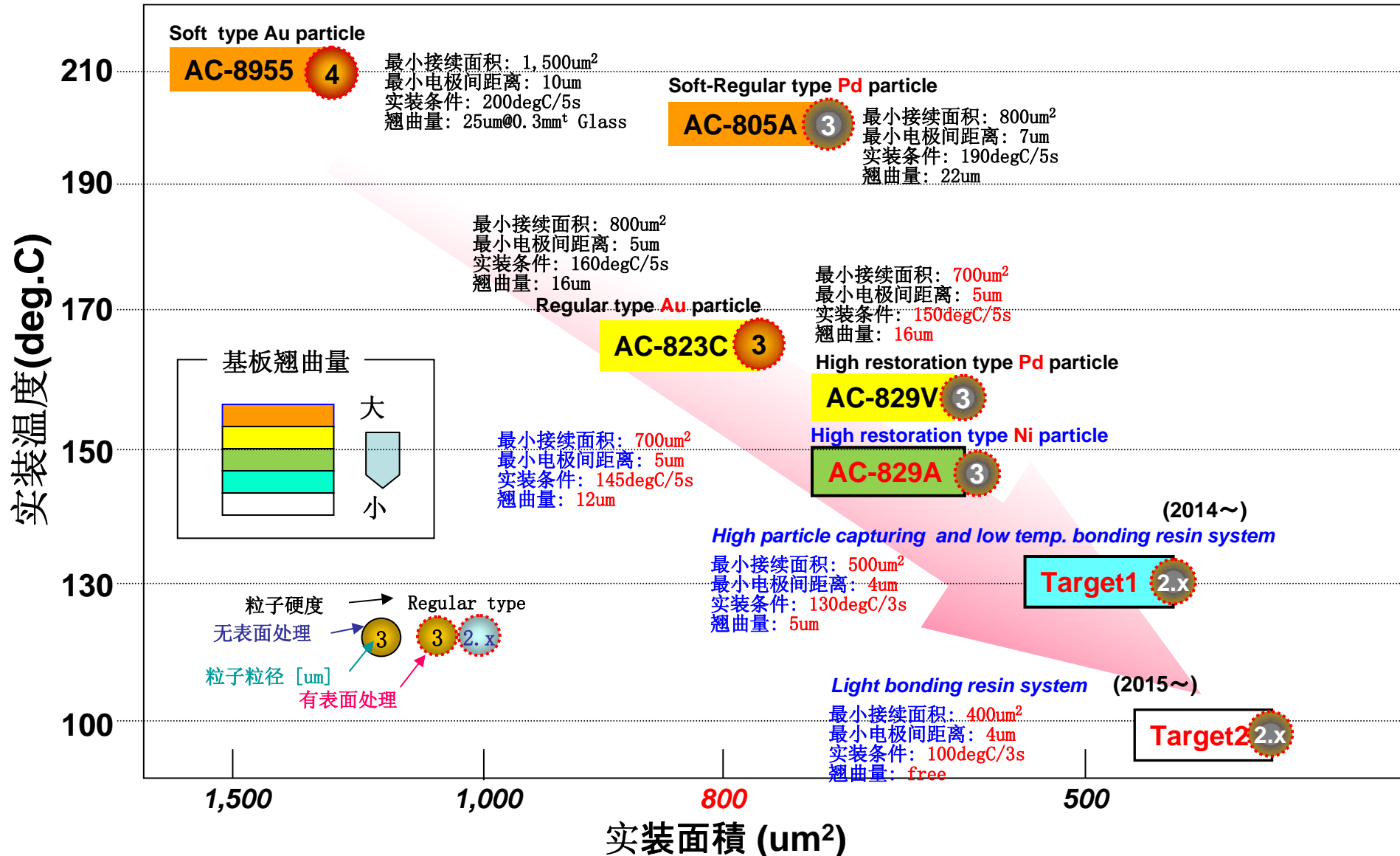


COG连接用的ACF型号一览表



* 最小接续面积：安装时偏位后的Bump和玻璃电极重合的面积（粒子捕捉数：Ave-3σ > 3pcs）
 * 最小电极间距离：安装时偏位后Bump和最近玻璃电极之间的距离

COG用ACF的一般特性

ACF			AC-8955	AC-805A	AC-823C	AC-829V	AC-829A
特征	树脂系		标准	高精細	低温 高精細	低温 高精細	低温 低应力树脂 高精細
	对应基板		STN / TFT	STN / TFT	TFT	TFT	TFT
厚度		um	23	20	20	18	18
导电粒子	种类	-	Au/Ni plastic particle Surface treated	Pd/Ni plastic particle Surface treated	Au/Ni plastic particle Surface treated	Pd/Ni plastic particle Surface treated	Ni plastic particle Surface treated
	粒径	um	4	3	3	3	3
	密度	pcs./mm ²	37,000	50,000	58,000	60,000	65,000
最小接续面积 *1		um ²	1,500	800	800	700	700
最小Bump间距离		um	15	10	12	10	12
最小电极间距离		um	10	7	7	5	5
电极高度		um	5~19	5~17	8~17	6~15	4~15
贴附	温度	degC	60~80	50~70			
	时间	Sec	1~2	1~2			
	压力	Mpa	1	1			
本压	温度 & 时间	degC - Sec	200-5	190-5	160-5	150-5	145-5
	压力	MPa	40~120	60~120	30~120	30~120	40~120

*1) 指实装后的Bump和玻璃电极之间的有效接续面积。日立化成测试基板计算的粒子捕捉面积为 Ave-3s ≧ 3